

光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260710

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	人保资产、彬元资本、聚鸣投资、鑫澜睿运、长江证券、东方财富证券、中原证券、湘财证券、华源证券、兴业证券等
时间	2026 年 7 月 8 日-2026 年 7 月 10 日
地点	公司郑州航空港厂区 2 号楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：吕琦 证券事务代表：关平丽
投资者关系活动主要内容介绍	各位投资者与公司管理层就公司的业务情况进行交流，并参观了生产车间、展厅等区域，主要内容如下： 1、公司国产半导体业务产能利用率情况？如何提升产能保证订单交付？ 答：公司国内半导体设备产能目前处于满产状态，公司一直在通过充分利用生产资源、优化生产流程、提升生产效率等方式，尽可能提升现有生产能力以满足订单需求。公司半导体产能扩产按照既定计划在顺利推进中。 2、公司半导体业务扭亏为盈后，盈利能力能否持续提升？ 答：2026 年一季度，公司国产半导体业务扭亏为盈；公司将紧抓行业上行机遇，加快市场拓展以及新产品的导入，并围绕客户需求持续技术创新、产品迭代，不断推进精益生产、降本增效，提升公司盈利能力。 3、公司刀片耗材的进展情况？ 答：海外子公司研发生产的软刀耗材处于行业领先地位，经过几十年的技术迭代和应用积累，性能稳定可靠，已有上千种型号软刀，产品

	持续销往全球包括头部封测企业在内的众多客户；国产化软刀已有部分型号实现批量供货，硬刀产品目前正在客户端验证。我们在努力加快推动刀片耗材国产化进程。 4、公司在销售划切设备时，是否搭配刀片耗材一起销售？ 答：刀片作为通用化耗材，可适配国内外市场不同品牌的划片机；客户在购买设备时可以选择是否搭配刀片购买；公司是业内少数同时具有半导体划切设备、空气主轴等核心零部件及刀片耗材的厂商，划切设备、核心零部件和刀片耗材的搭配可以为客户在不同场景的划切需求提供定制化的、最具性价比的解决方案。 5、公司激光划片机的进展情况？与其他厂商相比有无优势？ 答：公司激光开槽机正在客户端验证，激光隐切机已试切多批客户样片，客户反馈良好。 公司在精密机械划片机领域深耕多年，已掌握丰富的精密设备加工制造经验和切割工艺。同时，海外子公司为海外头部晶圆厂提供过定制化的半导体激光晶圆表面处理设备，为公司激光划片机的设计及工艺开发积累了产业化经验与数据。这些积累为公司研发新的激光加工设备奠定了基础。公司将基于现有技术积累，面向先进封装工艺进行针对性开发，并依托国内外研发团队的技术协同优势，力求在产品性能指标、客户需求响应及工艺迭代等方面建立起差异化优势。 6、公司研磨机的应用场景主要有哪些？进展如何？ 答：公司的全自动晶圆研磨机设备可用于 6/8/12 英寸硅、碳化硅等晶圆的研磨减薄工艺，晶圆级 Fan-out（扇出）研磨工艺等；全自动研磨抛光一体机可以实现晶圆的背面研磨和抛光加工，可用于 12 寸超薄晶圆减薄、抛光加工，适配 SDBG、DBG 等工艺；可满足 2.5D/3DIC、Chiplet 等先进封装工艺的晶圆背面研磨、应力消除等。 公司研磨机已在客户端验证，研磨抛光一体机正在进行研发样机的功能性测试。公司将全力加快推进产品验证尽快形成销售订单。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 7 月 10 日